



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, INOVAÇÃO, COMERCIO E  
SERVIÇOS**

**CONSULTA PÚBLICA Nº 03 - SEI, 24 DE FEVEREIRO DE 2023**

A Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial SEPEC-ME/MCTIC nº 32, de 15 de julho de 2019, torna pública a proposta de **fixação** do Processo Produtivo Básico – PPB de "**TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO PARA TRIAGEM PRÉ-AMBULATORIAL**".

O texto completo está disponível no sítio da Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, no endereço:

<https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/processo-produtivo-basico-ppb/novo-portal/consultas-publicas>

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes e-mails: [cgel.ppb@economia.gov.br](mailto:cgel.ppb@economia.gov.br), [cgct.ppb@mcti.gov.br](mailto:cgct.ppb@mcti.gov.br) e [cgpri.ppb@suframa.gov.br](mailto:cgpri.ppb@suframa.gov.br).

**UALLACE MOREIRA LIMA**

Secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços

## ANEXO

### PROPOSTA Nº 048/22 – FIXAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO PARA TRIAGEM PRÉ-AMBULATORIAL.

**OBS.:** A consulta está em forma de Portaria na versão da Lei de Informática, mas também vale para a versão da Zona Franca de Manaus.

Art. 1º O Processo Produtivo Básico para o produto TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO PARA TRIAGEM PRÉ-AMBULATORIAL, industrializado no País, é composto pelas etapas e respectivas pontuações relacionadas nas tabelas constantes dos Anexos I e II desta Portaria Interministerial.

§ 1º Os pontos totais serão atribuídos a cada etapa de produção realizada, de acordo com os dispostos nos Anexo I e II, sendo que a empresa deverá acumular a pontuação mínima por ano-calendário, dependendo do enquadramento do produto, conforme abaixo:

I - terminal de autoatendimento para triagem pré-ambulatorial contendo no mínimo medições de: pressão não invasiva, saturação do oxigênio no sangue e temperatura corporal: 797 (setecentos e noventa e sete) pontos; e

II - terminal de autoatendimento para triagem pré-ambulatorial contendo no mínimo medições de: eletrocardiograma, pressão não invasiva, saturação do oxigênio no sangue, peso, altura e temperatura corporal: 765 (setecentos e sessenta e cinco) pontos;

§ 2º O projeto de desenvolvimento a que se refere a etapa I dos Anexos I e II só será pontuado para o produto que atenda às especificações, normas e padrões adotados pela legislação brasileira e cujas especificações, projetos e desenvolvimentos tenham sido realizados no País, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e domiciliados no Brasil e atendam às Portarias específicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI.

Art. 2º O investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA) ao exigido pela legislação a que se refere a etapa II dos Anexos I e II deverá ser aplicado em programas e projetos de interesse nacional nas áreas de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação - CATI.

§ 1º O investimento a que se refere o **caput** deste artigo deverá ser calculado sobre o faturamento bruto incentivado no mercado interno, decorrente da comercialização dos produtos a que se refere esta Portaria, nos termos dos §§1º e 2º do art. 9º do Decreto nº 10.356, de 20 de maio de 2020.

§ 2º A comprovação do investimento em PD&IA deverá ser apresentada de forma discriminada junto com o relatório descritivo referente à obrigação estabelecida na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

§ 3º Para efeito do disposto no **caput** deste artigo, serão considerados como aplicação em atividades de PD&IA do ano-calendário os dispêndios correspondentes à execução de tais atividades realizados até 31 de março do ano subsequente.

Art. 3º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

## ANEXO I

### Terminal de autoatendimento para triagem pré-ambulatorial contendo no mínimo medições de: pressão não invasiva, saturação do oxigênio no sangue e temperatura corporal

Etapa	Descrição da Etapa Produtiva	Pontuação Total
I	Projeto de desenvolvimento no País – Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTI nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, ou Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018, ou Portaria MCTI nº 4.514, de 2 de março de 2021.	80
II	Investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA), valendo 20 pontos para cada 1% investido adicionalmente em P&D, limitado a um máximo de 60 pontos.	60
III	Desenvolvimento do software embarcado de baixo nível ( <i>firmware</i> ) da placa de circuito impresso responsável pelo processamento central (CPU).	20
IV	Processo de pintura eletrostática do gabinete.	110
V	Dobra, estampagem, soldagem, injeção plástica, moldagem e/ou outro processo de conformação (impressão 3D), conforme aplicável, do gabinete do terminal e suportes: impressora, oxímetro, medidor de pressão não invasiva, termômetro, leitor de cartão magnético, leitor de código 2D, monitor (com tela sensível ao toque " <i>touch screen</i> ") e apoio para antebraço.	385
VI	Montagem e soldagem, ou processo equivalente, de todos os componentes nas placas que implementem a função de processamento central ou da placa principal da CPU ( <i>Central Process Unit</i> ).	86

VII	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem a função de processamento central da impressora, montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes, exceto da cabeça de impressão térmica, integração das placas e demais partes elétricas e mecânicas.	50
VIII	Montagem e soldagem de componentes na placa principal de circuito impressos da unidade de saída por vídeo (monitor) com tela sensível ao toque ("touch screen").	61
IX	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de fonte de alimentação de energia ou módulo de bateria.	49
X	Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico das placas de circuito impresso que implementem a função de processamento central ou da placa principal da CPU ( <i>Central Process Unit</i> ).	80
XI	Corte do <i>wafer</i> e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória volátil do tipo RAM.	59
XII	Corte do <i>wafer</i> e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória do tipo não-volátil do <i>Solid State Drive (SSD)</i> ou <i>on board</i> .	61
XIII	Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação final do produto.	50
XIV	Testes.	10
<b>TOTAL</b>		<b>1.161</b>
<b>META</b>		<b>797</b>

## ANEXO II

**Terminal de autoatendimento para triagem pré-ambulatorial contendo no mínimo medições de: eletrocardiograma, pressão não invasiva, saturação do oxigênio no sangue, peso, altura e temperatura corporal**

<b>Etapa</b>	<b>Descrição da Etapa Produtiva</b>	<b>Pontuação Total</b>
I	Projeto de desenvolvimento no País – Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTI nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, ou Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018, ou Portaria MCTI nº 4.514, de 2 de março de 2021.	80
II	Investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA), valendo 20 pontos para cada 1% investido adicionalmente em P&D, limitado a um máximo de 60 pontos.	60
0III	Desenvolvimento do software embarcado de baixo nível ( <i>firmware</i> ) da placa	20

	de circuito impresso responsável pelo processamento central (CPU).	
IV	Processo de pintura eletrostática do gabinete.	60
V	Dobra, estampagem, soldagem, injeção plástica, moldagem e/ou outro processo de conformação (impressão 3D), conforme aplicável, do gabinete do terminal e suportes: impressora, oxímetro, medidor de pressão não invasiva, termômetro, leitor de cartão magnético, leitor de código 2D, monitor (com tela sensível ao toque " <i>touch screen</i> ") e apoio para antebraço.	180
VI	Dobra, estampagem, soldagem, injeção plástica, moldagem e/ou outro processo de conformação (impressão 3D), conforme aplicável, do estadiômetro, balança e ECG.	82
VII	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso e montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes, do módulo de controle de sensores.	139
VIII	Montagem e soldagem de componentes na placa principal de circuito impressos, integração das placas e demais partes elétricas e mecânicas do monitor multiparamétrico.	136
IX	Integração das placas de circuitos impressos, partes elétricas e mecânicas da balança.	10
X	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso para controle funcional dos leds e estadiômetro.	5
XI	Montagem e soldagem, ou processo equivalente, de todos os componentes nas placas que implementem a função de processamento central ou da placa principal da CPU ( <i>Central Process Unit</i> ).	81
XII	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem a função de processamento central da impressora, montagem das partes elétricas e mecânicas totalmente desagregadas em nível básico de componentes, exceto da cabeça de impressão térmica, integração das placas e demais partes elétricas e mecânicas.	40
XIII	Montagem e soldagem de componentes na placa principal de circuito impressos da unidade de saída por vídeo (monitor) com tela sensível ao toque (" <i>touch screen</i> ").	34
XIV	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de fonte de alimentação de energia ou módulo de bateria.	23
XV	Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico das placas de circuito impresso que implementem a função de processamento central ou da placa principal da CPU ( <i>Central Process Unit</i> ).	62
XVI	Corte do <i>wafer</i> e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória volátil do tipo RAM.	44
XVII	Corte do <i>wafer</i> e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória do tipo não-volátil do <i>Solid State Drive (SSD)</i> ou <i>on board</i> .	45

XVIII	Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação final do produto.	50
XIX	Testes.	10
<b>TOTAL</b>		<b>1.161</b>
<b>META</b>		<b>765</b>